株主メモ

上場証券取引所	東京証券取引所　マザーズ
事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
株式の売買単位	100株
公告方法	公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
公告掲載URL	http://www.teraprobe.com/
株主名簿管理人	三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
電話照会先	30120-782-031
インターネットホームページURL	http://www.smtb.jp/personal/agency

ホームページのご案内

当社では、株主・投資家の皆様にプレスリリースや決算説明資料などのIR情報をホームページにて公開しております。是非、ご覧ください。

株式会社テラプローブ
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-17
TEL:045-476-5711
ホームページアドレス **http://www.teraprobe.com/**

ターンキーサービスで新たな価値を創造する

Tera Probe

第9期
中間ビジネスレポート

テラプローブ ビジネスレポート 2013

証券コード:6627

ごあいさつ

代表取締役社長兼CEO
渡辺　雄一郎

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

日本経済は政権交代を契機として減速モードから抜け出す機運が徐々に高まっていますが、日本の半導体産業はまさに試練の時を迎えていると言わざるを得ません。一方、世界的に見れば半導体産業は拡大を続けており、成長産業となっています。

テラプローブは2005年の創業以来、主にテストビジネスを中心に事業を展開して参りました。しかしながら、昨今の事業環境の変化を考慮し、日本に本社を置きながらも世界の半導体市場と共に発展するグローバルカンパニーとなることを目指して、テラプローブは平成25年10月1日に100%子会社のテラミクロスを吸収合併いたしました。

この合併を第2の創業とし、テラプローブは従来のテストハウスから、独自の技術に基づいたCSP (Chip Size Package) ビジネスを核とする “SAMURAI CSP Provider”として、CSPとテストを総合的に提供するプロバイダへと進化してまいります。

”SAMURAI CSP Provider“とは、テラプローブが日本企業として長年培った骨太の技術と世界に誇る品質保証体制を基に、しなやかな顧客対応力、市場対応力を世界のお客様に提供していく決意を表したものです。当社は”SAMURAI CSP Provider“として、お客様の製品の付加価値向上を支える企業を目指してまいります。

また、当社はDRAMを初めとする半導体テストと、CSPの中でも品質に優位性がある、ウエハレベルパッケージを包括的に提供するターンキーサービスを充実させ、半導体産業の中心地である台湾を足がかりに、アジア地域におけるビジネス展開を図ってまいります。

これからもテラプローブは世界市場に変革を起こす日本発SAMURAI企業としてお客様と社会に貢献してまいりますので、引き続き皆様方のご支援をお願い申し上げます。

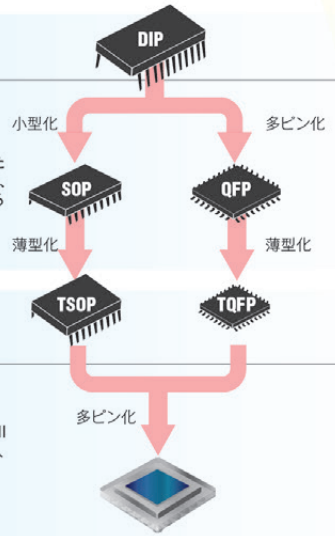
LSI パッケージの進化 ～WLP が誕生するまで～

パッケージ外形の変遷

携帯電話、スマートフォンなどの携帯情報機器の急速な普及に伴い、各種電気・電子機器は更なる小型化、軽量化、高機能化、高速化を追及してきました。これらを実現するために、LSIをはじめとする電子部品の小型化、高集積化と、それらの部品の高密度実装技術が開発されてきました。

1st Generation　第1世代　1960年～

リードフレームをガルウイング状に四方に張り出したタイプ、QFP（Quad Flat Package）の登場により、表面実装が可能になり、ピンを直接基板に挿入する必要が無くなりました。



2nd Generation　第2世代　1990年～

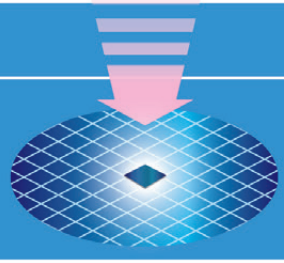
ボール形状の端子を格子状に配置するBGA（Ball Grid Array）が登場。QFPよりも小型化を実現し、高密度な表面実装が可能になりました。

3rd Generation　第3世代　1995年～

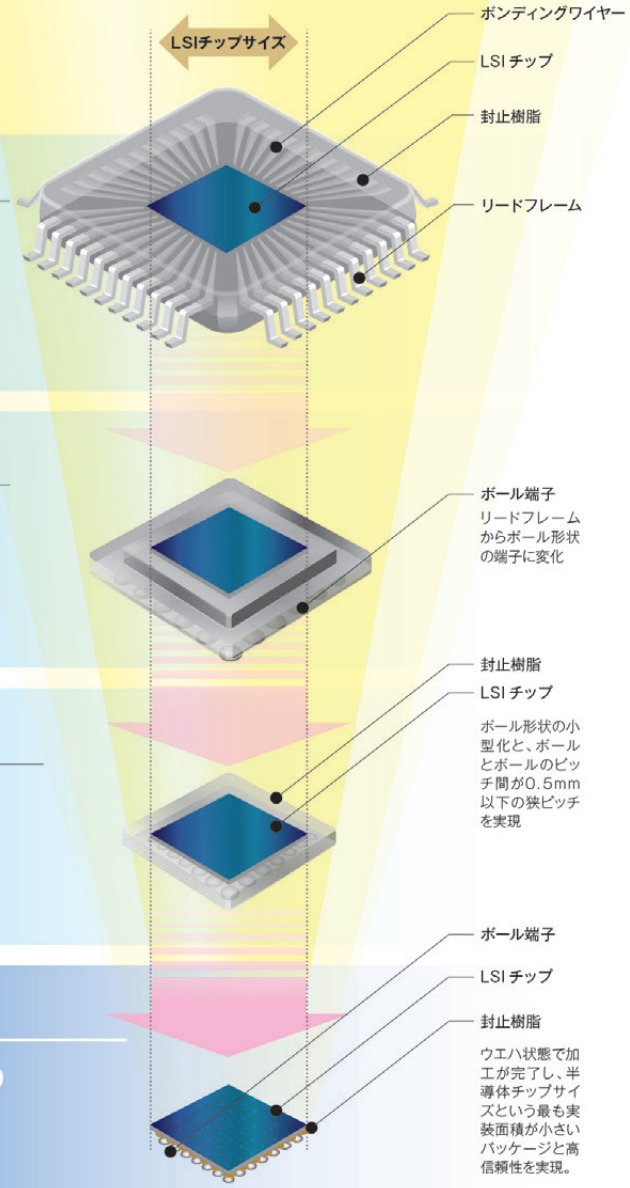
BGA を更に高密化するため、ボール・ピッチを縮小する技術開発が推し進められ、『チップサイズと同等あるいはわずかに大きいパッケージ』とする、CSP（Chip Size Package）が登場。

4th Generation　第4世代　2002年～

半導体製造プロセスを用いて、ウエハ状態のまま半導体チップと同じサイズのパッケージを実現する、WLP（Wafer Level Package）が登場。



LSIの実装サイズ比較



Q. 世界の半導体市場に進出するうえで、強みは何ですか?

A. WLP、EWLPを含むCSPとテストのトータル・ソリューションです。

CSP(Chip Size Package)は半導体パッケージの中でも、最も小さいカテゴリーに入り、スマートフォンやデジタルカメラなどの電子機器において、薄型化・軽量化を実現する実装技術として採用されています。その中で、WLP(Wafer Level Package)はウエハ状態でパッケージ工程が完了する技術です。

また、当社で作られたWLPは顧客にてEWLP(Embedded Wafer Level Package)に搭載が可能です。EWLPは基板内にWLPを埋め込んで、実装基板の更なる省スペース化を実現するパッケージです。

テストにおいては広島、九州の国内量産拠点及び世界の半導体生産の中心地である台湾にも量産拠点を展開し、お客様のニーズに合わせた最適なテストを実行するため、テスタをはじめとする設備を揃えています。個々に最適化したウエハテスト、ファイナルテスト及びテストプログラム開発まで含めたトータル・ソリューションを提供しています。

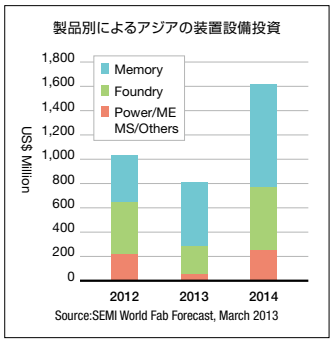
WLPとEWLP(Embedded Wafer Level Package:WLP埋込み基板)

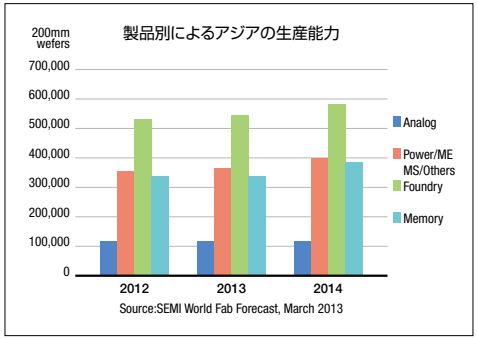
Q. 半導体産業で今注目されている地域とは?

A. 台湾を初めとするアジア地域です。

SEMI通信2013年4月号の記事では、アジア地域について、メモリ用を始めとする製造装置設備投資が2013年の前半に底を打って徐々に持ち直し、続く2014年には力強く回復することが予測されています。

また、アジアにおける8インチウエハの生産キャパシティは、2012年を底に増加傾向にあると予測しています。





Q. 台湾にあるTeraPowerの役割は?

A. アジア進出の要となる生産拠点です。

台湾の産業情報研究所(MIC)が9/17に公表した資料によると、2014年台湾の半導体産業は国際競争激化やICチップの価格下落等により、成長が鈍化しながらも伸び率は7.8%と、世界平均を上回る水準になると予測しています。

その台湾市場において、当社グループの先頭に立っているのがTeraPowerです。TeraPowerは汎用DRAMを中心に、小容量メモリなど主にメモリ製品のテストを受託しています。さらに、多様化する顧客の要望にも柔軟に対応し、メモリ以外にシステムLSIのテストにも力を入れ、ビジネスを拡大しています。

テラプローブ・グループは日本の半導体メーカーや海外のファブレスメーカー(自社で生産設備を持たないメーカー)などを中心に、台湾ファウンダリ(半導体チップの製造を専門に行う企業)を利用する顧客のテスト受託を強化し、グローバルカンパニーを目指します。

TeraPower外観

連結財務諸表

連結貸借対照表

（単位：百万円）

科目	前期末（2013年3月31日）	当上期末（2013年9月30日）
〈資産の部〉		
流動資産合計	11,022	13,743
固定資産合計	24,519	22,357
資産合計	**35,542**	**36,101**
〈負債の部〉		
流動負債合計	7,760	9,351
固定負債合計	5,544	4,362
負債合計	**13,304**	**13,714**
〈純資産の部〉		
株主資本合計	20,145	20,179
その他の包括利益累計額	△43	76
少数株主持分	2,135	2,130
純資産合計	22,237	22,386
負債純資産合計	**35,542**	**36,101**

連結損益計算書

（単位：百万円）

科目	前上期（2012年4月1日～2012年9月30日）	当上期（2013年4月1日～2013年9月30日）
売上高	**11,506**	**10,792**
売上原価	**9,883**	**9,690**
売上総利益	**1,623**	**1,102**
販売費及び一般管理費	1,152	1,032
営業利益	**470**	**70**
営業外収益合計	40	97
営業外費用合計	205	118
経常利益	**305**	**49**
特別利益合計	125	0
特別損失合計	1	2
税金等調整前四半期純利益	**429**	**47**
法人税等	**△17**	**△12**
少数株主損益調整前四半期純利益	**82**	**25**
少数株主利益	**447**	**60**
当期純利益	**365**	**34**

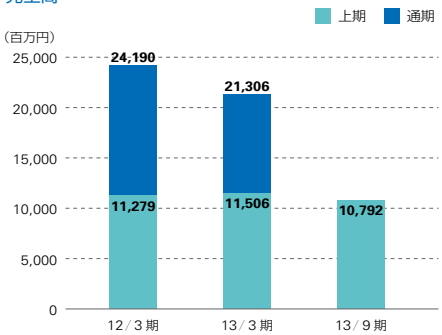
連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

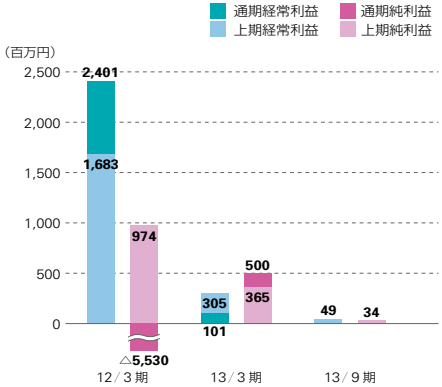
科目	前上期（2012年4月1日～2012年9月30日）	当上期（2013年4月1日～2013年9月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー	**4,950**	**3,439**
投資活動によるキャッシュ・フロー	**△2,244**	**△1,403**
財務活動によるキャッシュ・フロー	**△2,577**	**△1,630**
現金及び現金同等物に係る換算差額	**△35**	**58**
現金及び現金同等物の増減額(△減少)	**94**	**464**
現金及び現金同等物の期首残高	**5,557**	**6,043**
現金及び現金同等物の四半期末残高	**5,651**	**6,507**

財務ハイライト

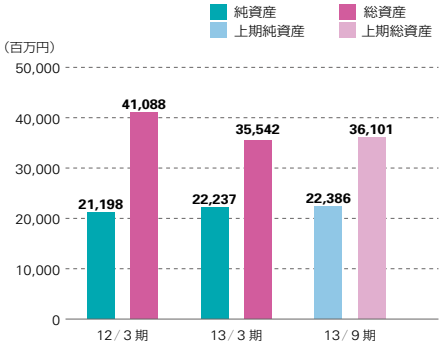
売上高



経常利益・純利益



純資産・総資産



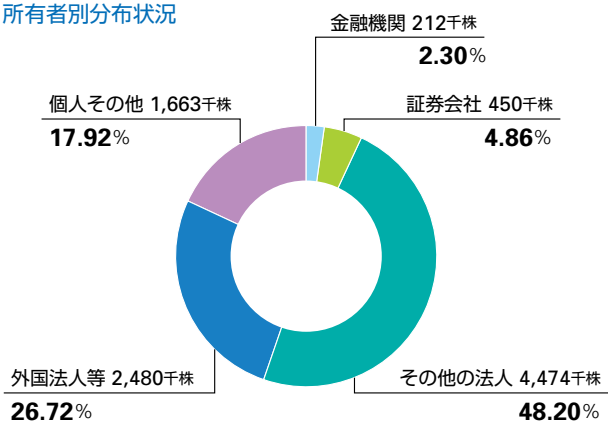
株式情報 (2013年9月30日現在)

会社が発行する株式の総数	30,000,000株
発行済株式の総数	9,282,500株
株主数	2,479名

大株主の状況

株主名	所有株式数(株)	持株比率(%)
エルピーダメモリ株式会社	3,680,000	39.64
MSIP CLIENT SECURITIES	1,083,300	11.67
株式会社アドバンテスト	760,000	8.18
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	611,773	6.59
UBS AG HONG KONG	305,800	3.29
株式会社SBI証券	184,800	1.99
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	112,000	1.20
神 林 忠 弘	106,100	1.14
立花証券株式会社	101,300	1.09
松井証券株式会社	82,100	0.88
計	7,027,173	75.70

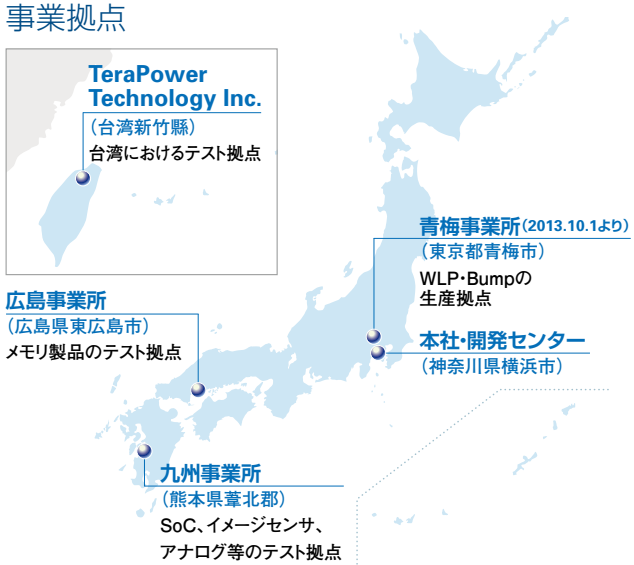
所有者別分布状況



会社概要 (2013年9月30日現在)

社名	株式会社テラプローブ (英文：Tera Probe, Inc.)
設立	2005年8月
資本金	11,823百万円
従業員	321名(単体)、669名(連結)
事業内容	●メモリ事業 (DRAM等のメモリ製品のウエハテスト、ファイナルテスト、開発受託及びWLP・Bumpの受託加工) ●システムLSI事業 (SoC、イメージセンサ、アナログ等 各種半導体製品のウエハテスト、ファイナルテスト、開発受託、WLP・Bumpの受託加工)

事業拠点



役員の状況 (2013年9月30日現在)

代表取締役社長	渡辺雄一郎
代表取締役副社長	小平広人
取締役	横山毅
社外取締役	森直樹
常勤監査役	増子尚之
監査役	縣啓二
監査役	檜垣修